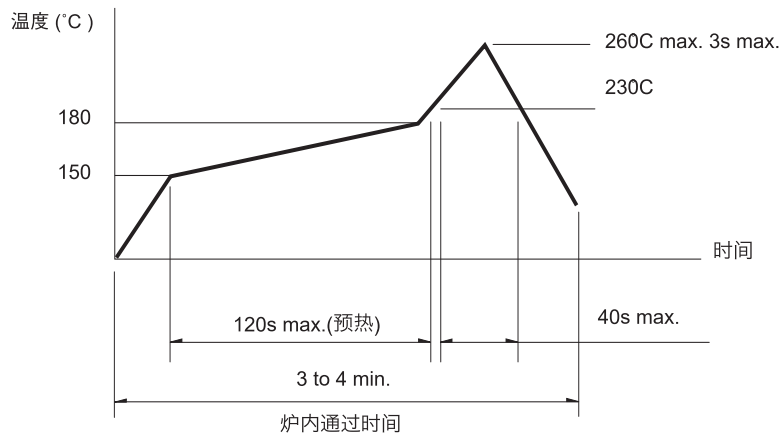


Circuit Diagram

焊接条件/Welding conditions

回流焊时/During reflow soldering

适用于表面贴装型温度分布/Applicable to surface mount temperature distribution



注/notes

- 关于详细条件，请于本公司的产品规格书进行确认。
Please confirm the detailed conditions in our product specification
- 根据贴面焊槽的种类，条件不同结果不同，请事先充分进行确认之后使用。
According to the type of veneer welding groove and different conditions, the results are different. Please fully confirm before using.

自动浸焊式/Automatic dip welding

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

注/notes

- 请不要从轻触开关上面浸入助焊剂。
Do not immerse the flux on the touch switch
- 请不要事前在开关端子及印刷电路板的零部件贴装面上涂助焊剂。
Please do not apply flux on the mounting surface of switch terminals and printed circuit board components in advance
- 进行第 2 次焊接时，应在开关回复到常温之后进行。
The second welding shall be carried out after the switch returns to normal temperature.

手焊式/Hand welded

项目	条件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.